

性能特点

- 具有良好的导热性
- 单组分无需混合，便于操作
- 加热快速固化，适合回流焊
- 固化过程无副产物释放
- 优越的耐高低温、耐气候及介电性能
- 优越的化学和机械稳定性
- 与大部分介质粘接性好

产品描述

PAKCOOL® TC-9115 是单组分加热固化液态导热硅胶粘合剂，具有对电子器件导热和粘接功效。对铜、铝、不锈钢以及电路板等各种材料有良好的粘接性。固化无副产物释放，可以用于大面积、深部以及完全封闭的场合。对金属和非金属表面不产生腐蚀。固化前是粘性液体，可在一定压力下流动。固化后与其接触表面紧密贴合，形成强力的粘接性能。

本系列产品具有导热性能高、绝缘性能好以及便于使用等优点，可广泛用于各种需要粘接性又需要导热的场合。

本系列产品在高温下快速固化，达到很高的粘接强度，可适用于回流焊工艺。

典型应用

- 太阳能板粘接导热
- 大功率 LED
- 功率模块/电源模块
- 车用电子产品
- 集成芯片
- 通讯设备
- 计算机及其附件
- 回流焊工艺

注意事项

- 由于本产品是单组分粘合剂，成品的粘度会随着贮藏的时间变长而升高，客户应在尽可能在短时间内用完，以免粘度的变化带来操作的不便。
- 如客户需要更详细的说明，请与我公司市场销售部联系。他们会随时为您解答和服务。

技术参数

特性	TC-9115	测试方法
外观	白色	Visual
粘度 (cP)	11 万±5 万	ASTM D2196-15
导热系数 (W/m·K)	1.5	ASTM D5470
密度 (g/cm³)	2.60±0.10	ASTM D792
硬度 (Shore A)	72.5±12.5	ASTM D2240
无底涂粘结强度 (MPa @150°C×1h)	≥2.6	Aluminum lap shear
固化时间 (min, @150°C)	60	--
介电强度 (kV/mm)	≥10	ASTM D149
体积电阻率 (Ω·cm)	≥1.0×10 ¹²	ASTM D257
储藏时间 (@<0°C)	<3 months	--
储藏时间 (@<20°C)	<20 days	--
连续使用温度(°C)	-50~+200	--

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

使用方法

- 涂胶前，元器件表面应保持清洁。
- 使用时带防护眼镜和防护手套，使用环境需通风。
- 产品接触有些物质可能会不固化或不完全固化，这些物质包括：硫、磷、氮的化合物如聚砷、聚硫醚、聚氨基酯、含酰胺、胺的物质，含锡、砷、锑、硒、碲成分的物质及一些不饱和的碳氢化合物及增塑剂等。

包装储运

- 本产品可提供 30mL、55mL 点胶针筒，330mL 支装，或根据客户要求定制包装。
- 产品收到应立即冷冻存储，在开盖使用前，应在使用温度下进行回温，根据冷冻温度和产品的数量，需回温 2-8 小时或以上，使产品达到使用温度，避免因温度低造成挤出慢或冷凝水附着影响固化和固化后的粘接强度。
- 避光阴凉，冷冻储存，贮藏的温度尽可能低。
- 低温运输，运输温度尽量低于 20°C，运输时间应以 5 日以内为好。

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。